

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘伟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股

份总数 123,449,335 股，占公司有表决权股份总数的 75.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟竞拍国有土地使用权的议案》

1. 议案内容：

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金竞拍位于北京市大兴区新城东南片区 0605-022B 块地工业用地，总价款不超过 7000 万元人民币，约 3.40 万平方米（最终面积以土地权属证书登记的为准）国有土地使用权，用作公司研发和生产制造的建设用地。董事会授权公司管理层先行办理购置土地竞拍保证金缴纳事项，待股东大会审议通过后办理相关后继手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,449,335 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日